

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成20年3月6日(2008.3.6)

【公開番号】特開2002-225204(P2002-225204A)

【公開日】平成14年8月14日(2002.8.14)

【出願番号】特願2001-20901(P2001-20901)

【国際特許分類】

B 3 2 B 27/30 (2006.01)

B 0 5 D 7/24 (2006.01)

B 3 2 B 37/00 (2006.01)

C 0 8 J 7/00 (2006.01)

C 0 8 L 79/08 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 27/30 D

B 0 5 D 7/24 3 0 1 T

B 0 5 D 7/24 3 0 2 L

B 3 2 B 31/28

C 0 8 J 7/00 C F G Z

C 0 8 J 7/00 3 0 5

C 0 8 L 79:08

【手続補正書】

【提出日】平成20年1月18日(2008.1.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 8】

被覆工程は、フッ素樹脂のペーストまたはフッ素樹脂を混入している溶液を基材の表面に塗布するか、あるいはフッ素樹脂フィルムを基材の表面に張り付けることによって実施することができる。この被覆工程に続く電離性放射線の照射は、無酸素雰囲気下で 2 5 0 ~ 4 0 0 の範囲の温度で行われ、かつ照射線量が 1 kGy ~ 1 0 MGy の範囲であるのが好ましい。